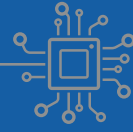




하 나 마 이 크 론
시 스템 반 도 체
TEST 지원 센터

Innovative
Semiconductor
Solution Provider



하나마이크론은

정부의 시스템 반도체 육성 정책에 부응하여,
시스템반도체 TEST지원센터를 신설하였습니다.

이를 통해, 시스템 반도체 업체들에게 개발 제품의 빠른 검증과 양산에 필요한
TEST Solution 및 TEST Infra 를 제공함으로써
국내 시스템반도체 육성 및 활성화에 기여하고자 합니다.

FABLESS/ DESIGN HOUSE/ FOUNDRY 등 다양한 업체 요구에 맞는
서비스를 제안하는 것은 물론, 하나마이크론이 영위하고 있는 주요 사업영역인
Bump, TEST (Probe/ Final), Package 등의 솔루션을
Turn-Key 로 연계할 수 있는 장점을 가지고 있어,
고객들에게 보다 확장성 있는 사업 기회를 제공할 수 있습니다.

HANA
MICRO
하나마이크론

시스템반도체 TEST지원센터 관련 다음 안내 사항을 확인하시고 문의 및 사용 예약은 회사 홈페이지를 방문하셔서 요청하실 수 있습니다.

TEST Platforms

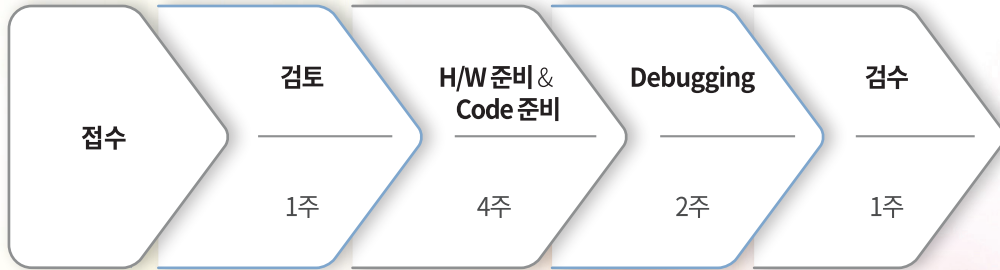
- TEST 서비스 Scope: Probe TEST, Final TEST, WLP TEST, System Level TEST
- 시스템반도체 TEST지원센터 - 하나마이크론 판교

Maker	Platform	Specification	Application
Teradyne	iFLEX	200MHz(192ch),30V(200mA),Audio,VHF	MCU, SOC, Audio, Sensor
	uFLEX	400MHz(5632ch), ±30V(1A), Audio,VHF	MCU, T-Con, SOC, AP
	J750EX	50MHz(192ch), 11/-2V(1A)	MCU, Sensor
Advantest	T2000	200MHz(256ch),8V(500mA),VHF	MCU, SOC, Sensor
Others	Prober	8", 12" Wafer Handle	
	Thermojet	Tri-Temp TEST(-50 ~ 150'C)	

※ Tester Configuration은 홈페이지 예약시스템을 참고 바랍니다.

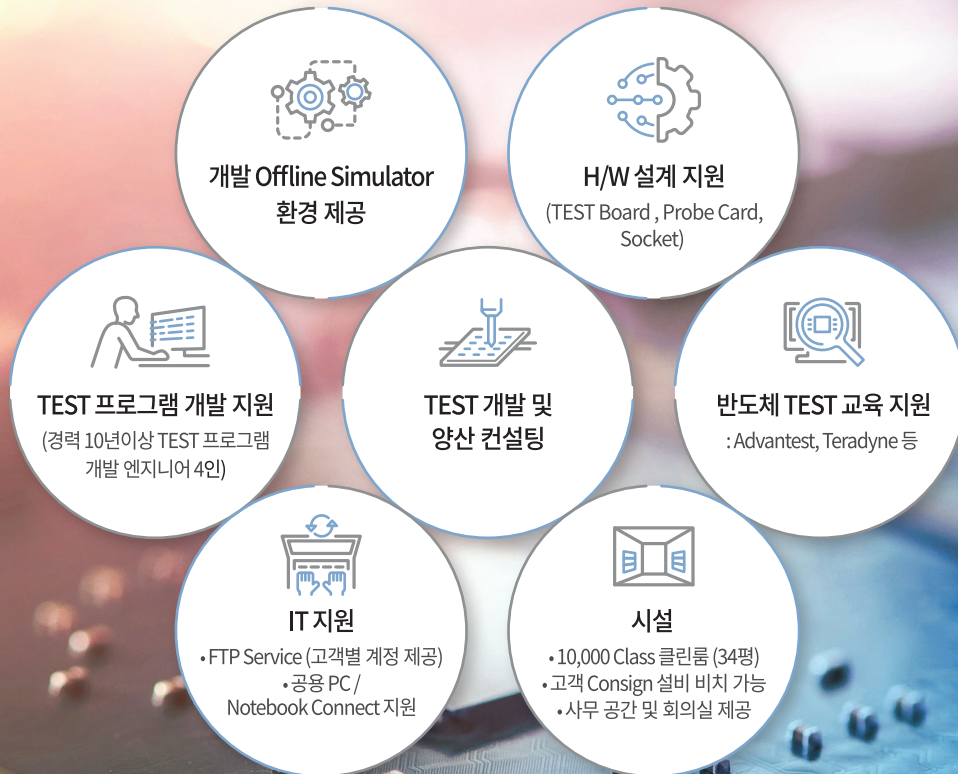


개발 TAT



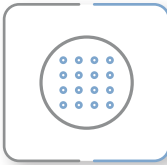
TEST 지원 SCOPE

고객 편의를 위한 환경 제공 및 TEST 관련 개발/ 교육을 지원합니다.



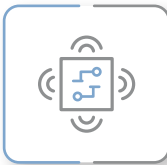
반도체 후공정 TURN-KEY 솔루션 기술 지원

Bump, TEST, Package, Module을 포함한 TURN-KEY 서비스는 고객에게 많은 기회와 이점을 제공할 수 있습니다.



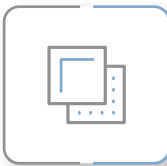
Bump

WLCSP, FLIP CHIP, SiP, FCQFN 등 Bumping이 적용된 다양한 솔루션 제공



TEST

Probe TEST, Final TEST, Wafer Level TEST, System Level TEST 솔루션 제공



Package 개발 / Package Design & Simulation 지원

최적의 구조, 고객 맞춤형 디자인 솔루션 제공



신뢰성 시험 및 불량분석

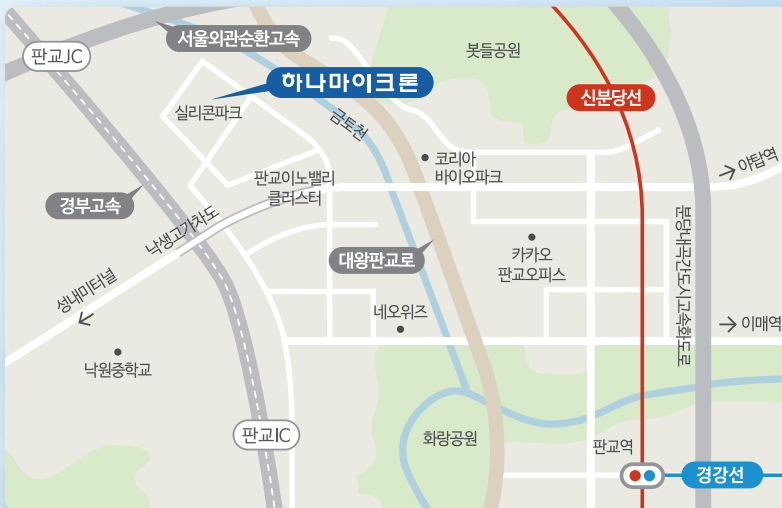
국제 규격을 기반으로 다양한 신뢰성 시험 및 불량 분석 INFRA 제공



서비스 예약 방법

- 회사 홈페이지 예약 등록 시스템 이용
(www.hanamicron.com ➔ 시스템반도체 TEST지원센터 예약등록시스템)
- 운영시간: 24시간 연중 무휴

위치



경기도 성남시 분당구
판교로 255번길 35,
판교실리콘파크 B1층
하나마이크론 판교 R&D 센터 內
시스템반도체 TEST지원센터



하나마이크론 본사/ 협력사 활용 가능 설비

Product Line - 하나마이크론 본사

Maker	Platform	Specification	Application
Teradyne	iFLEX	200MHz(768ch), 30~70V(0.2~2A), Audio, VHF, RF	T-Con, SOC, Audio, MCU
	uFLEX XC/XD	400MHz(5632ch), ±30V(1A), Audio/RF	AP, T-Con, SOC, MCU, 4G/Wifi6
	uFLEX Plus	400MHz(6144ch), ±20V(2A), Audio/VHF	AP, T-Con, SOC, MCU
	ETS364	66MHz(112ch), 30V(200mA), 100V(500mA)	PMIC, AF/OIS, Touch
Advantest	V93K(PS1600)	400MHz(384ch), Audio/Video, VHF, RF	T-con, SOC, MCU, 4G/LTE
	T2000	200MHz(2816ch), Audio/Video, VHF, RF	T-con, SOC, Audio, 4G/LTE
	T2000(IPS/GVI)	1GHz(512ch), ±160V(4A), Hi-Res WGD	MCU, PMIC, AF/OIS, Touch

Product Line - 노바세미

Maker	Platform	Specification	Application
Advantest	T2000(Air)	100MHz(512ch), 85V(240mA), 12V(0.5A)	MCU, PMIC, Touch(Small)/SAR
	T2000	1GHz (1536ch) , 80V(240mA) 200V/2A, Hi-Res WGD	AP, Large-PMIC, Micro-LED Driver, Touch(Large)

※ Test 지원센터 보유 설비 외 본사/협력사 설비는 원격으로 이용하실 수 있습니다.

www.hanamicron.com



HANA Micron R&D Center

주소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 9층 +82-31-698-9009 contact@hanamicron.com